

各位

2021年2月吉日

大阪大学 接合科学研究所 レーザプロセス学分野
准教授 佐藤 雄二

第2回「先進機能性表面・構造を創出するレーザー表層加工」研究集会のご案内

日時：令和3年2月22日(月) 13:00～17:00

会場：「Webex」によるオンライン会議

(アクセス方法は、参加申し込み頂いた後にメールでご案内します)

主催：大阪大学接合科学研究所 レーザプロセス学分野

参加費：無料

趣旨：レーザー表層加工は、ナノスケールからマクロスケールの表面微細構造の形成技術、光化学的な表面改質技術、コーティングによる付加加工技術など、新たな機能性表面を創生する手法として、近年、注目されている加工技術です。本研究集会では、「先進機能性表面・構造を創出するレーザー表層加工」をテーマに、最新のレーザー加工の研究動向を把握するとともに、次世代加工技術における研究課題やその応用等について議論を行います。

13:00～13:05	開会の挨拶
13:05～13:35	「高輝度・高効率青色半導体レーザー開発とその応用（仮） 大阪大学接合科学研究所・特任研究員 竹中 啓輔
13:35～14:05	「レーザー表層加工技術を用いた車載半導体パッケージにおける樹脂と金属の直接接合技術」 株式会社デンソー 神田 和輝
14:05～14:35	「金属/異種材料接合のためのレーザー表層加工技術「DLAMP」について」 ダイセルミライズ株式会社 板倉 雅彦
14:35～15:05	「レーザー誘起衝撃波による金属の表層加工」 近畿大学・講師 津山 美穂
15:05～15:25	休憩
15:25～15:55	「短波長光励起表面プロセスとその応用」 宮崎大学・准教授 甲藤 正人
15:55～16:25	「真空紫外エキシマランプを用いた表面改質の取り組み（仮）」 ウシオ電機株式会社 有本 太郎
16:25～16:55	「SiC/SiC CMC の加熱試験のための Selective Laser Thermoregulation 法の開発のための取り組み（仮）」 東京工科大学・准教授 大久保 友雅
16:55～17:00	閉会の挨拶

問い合わせ先：大阪大学接合科学研究所 レーザー表層加工研究集会事務局

laser_office@jwri.osaka-u.ac.jp 06-6879-8675

申し込み方法：事前申込み必須としております。参加をご希望の方は[こちらから](#)お申込み下さい。なお、先着順で予定人数に達し次第、締め切らせて頂きますのでご了承下さい。

【WEB開催の場合の講演・聴講上の注意】

- ・オンライン講演は、著作権法上の公衆送信にあたると考えられます。講演の際に引用する資料や映像・音声等のコンテンツは、著作権等の問題の無いものに限るようご注意ください。
 - ・通常開催と同様、受信画像や発表資料の撮影・録画（画面キャプチャを含む）、録音、保存、再配布は禁止します。
 - ・研究集会のログインID、パスワード、接続先URL等は、参加申込された方のみ有効です。不特定多数を含む第三者に公開する事はお止めください。不適切な接続が判明した場合、管理者側で切断する等の対応を取らせていただきます。
 - ・オンライン講演に際して万が一トラブル等が生じた場合、大阪大学接合科学研究所はその責任を負いません。
-
- ・大阪大学「[コロナ新時代における大阪大学の行動ガイドライン](https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun)」
<https://www.osaka-u.ac.jp/ja/news/info/corona/kijyun>